

⑪ 公開実用新案公報 (U)

昭62-178554

⑤ Int. Cl. 4
H 01 L 35/34
21/60

識別記号

厅内整理番号
7131-5F
6918-5F

⑬ 公開 昭和62年(1987)11月12日

審査請求 未請求 (全2頁)

⑭ 考案の名称 热電装置

⑪ 実願 昭61-65908
⑫ 出願 昭61(1986)4月30日⑬ 考案者 吉本 義房 平塚市四之宮2597番地 小松エレクトロニクス株式会社内
⑭ 出願人 小松エレクトロニクス 平塚市四之宮2597番地
株式会社
⑮ 代理人 弁理士 木村 高久

⑯ 実用新案登録請求の範囲

(1) 相対向するように配設された2つの熱交換基板の間に電極を介して少なくとも1つの熱電素子対からなる素子部を配設した熱電装置において、

前記電極は、各熱交換基板表面に形成された厚膜導体層パターンから構成されていることを特徴とする熱電装置。

(2) 前記熱交換基板は、アルミナセラミック基板からなり、前記厚膜導体層パターンは、銅の厚膜パターンであることを特徴とする実用新案登録請求の範囲第(1)項記載の熱電装置。

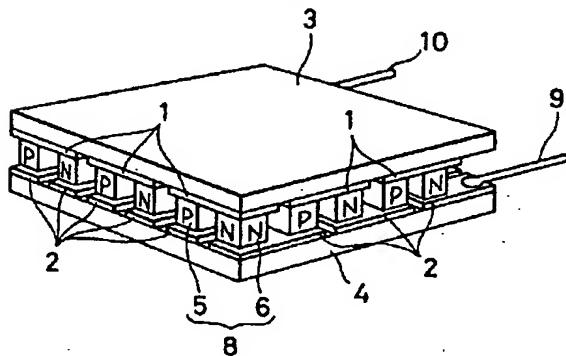
図面の簡単な説明

第1図は、本考案実施例の熱電装置の外観を示す

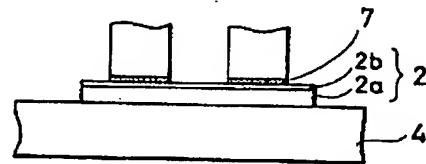
す図、第2図は同装置の要部拡大断面図、第3図および第4図は従来例の熱電装置を示す図である。

1 1 1 ……第1の熱交換基板、1 1 2 ……第2の熱交換基板、1 1 3 ……PN素子対、1 1 4 ……第1の電極、1 1 5 ……第2の電極、1 1 6 ……メタライズパターン、1 1 7 ……半田層、1 1 8 ……半田層、1 ……高温側接合用電極パターン、2 ……低温側接合用電極パターン、3 ……第1の熱交換基板、4 ……第2の熱交換基板、5 ……P型熱電素子、6 ……N型熱電素子、7 ……半田層、8 ……PN素子対、9, 10 ……リード、1 a, 2 a ……銅厚膜パターン、1 b, 2 b ……ニッケルメッキ層。

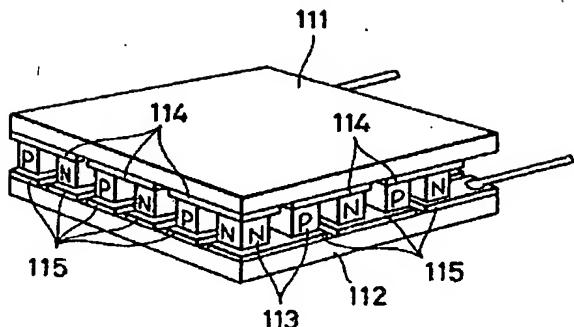
第1図



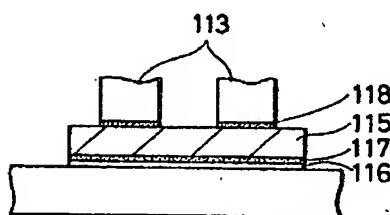
第2図



第3図



第4圖



補正 昭61. 6.13

実用新案登録請求の範囲を次のように補正する。

⑤ 実用新案登録請求の範囲

(1) 熱交換基板上に電極を介して少なくとも1つの熱電素子対からなる素子部を配設した熱電装置において、

前記電極は、各熱交換基板表面に形成された厚膜導体層パターンから構成されていることを特徴とする熱電装置。

(2) 前記熱交換基板は、アルミナセラミック基板からなり、前記厚膜導体層パターンは、銅の厚膜パターンであることを特徴とする実用新案登録請求の範囲第(1)項記載の熱電装置。